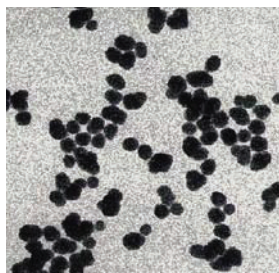
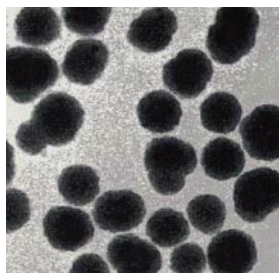


PLANERLITE

CMP



PLANERLITE-7101



PLANERLITE-4101



This photograph is an image.
Esta fotografía es una imagen.

PLANERLITE

The PLANERLITE series of polishing slurries is intended for use in chemical mechanical planerization (CMP), a key planerization process in the fabrication of high-density ULSI devices. It has been developed under the basic concepts of high purity, high removal rate, high dispersion and scratchfree performance.

PLANERLITE-4000 series

This polishing slurry is designed for use on SiO₂ films (interlayer dielectric, STI). Based on ultra-high purity colloidal silica or fumed silica, it is available in several grades with varying additives and abrasive particle concentration, enabling users to select the product optimal for their specific process parameters and cost/performance requirements.

PLANERLITE-6000 series

This polishing slurry is designed for use with polysilicon. There is a variety of types available, either polishing slurry based on ultra-high purity colloidal silica or rinsing agent with special additives which keeps post-polishing wafer surface hydrophilic. The polishing slurry, in all types has extremely high polysilicon removal rate with excellent selectivity to silicon oxide film. The rinsing agent helps prevent particle adhesion, simplifying wafer cleaning process. The entire line can be used at high dilutions, and adjustment of the dilution provides control of removal rate and selectivity while also delivering high cost/performance. Abrasive particles are completely dispersed, eliminating sedimentation in a high stable slurry.

PLANERLITE

La serie de pastas pulidoras PLANERLITE se ha creado para uso en planarización mecánica química (CMP), un proceso de planarización clave en la fabricación de dispositivos ULSI de alta densidad. Se ha desarrollado siguiendo los conceptos básicos de alta pureza, alto grado de eliminación, alta dispersión y rendimiento sin rayado.

Serie PLANERLITE-4000

Esta pasta pulidora se ha diseñado para uso en películas de SiO₂ (capas dieléctricas intermedias, STI). Con base de silicio coloidal ultrapuro o silicio pirógeno, está disponible en diversas calidades con aditivos y concentración de partículas diferentes, lo que permite a los usuarios seleccionar el producto que mejor se adapte a sus procesamientos específicos y requisitos de coste/rendimiento.

Serie PLANERLITE-6000

Esta pasta pulidora se ha diseñado para uso con polisilicio. Existen diversos tipos, bien se trate de pasta pulidora con base de silicio coloidal ultrapuro o agente de lavado con aditivos especiales que mantienen la superficie de la oblea hidrofílica después del pulido. Todos los tipos de pasta pulidora tienen un alto grado de eliminación del polisilicio con selectividad excelente ante película de óxido de silicón. El agente de lavado ayuda a evitar la adhesión de partículas, lo que simplifica el proceso de lavado de la oblea. La línea completa puede usarse con un alto grado de dilución, cuyo ajuste permite controlar a su vez el grado de eliminación y la selectividad, ofreciendo al mismo tiempo una buena relación coste/rendimiento. Las partículas abrasivas están completamente dispersas, lo que elimina la sedimentación para conseguir una pasta altamente estable.

■ PLANERLITE

PLANERLITE-7000 series

This polishing slurry is designed specifically for Cu metallization in the damascene process. Based on ultra high purity colloidal silica with special additives, it delivers high copper removal rate, with excellent selectivity to barrier metal. As a result, erosion is low and residual copper on the barrier metal is minimal, making it possible to completely stable, with no sedimentation, and minimal scratching. We also offer a high-dilution type, contributing to lower cost for copper damascene process.

PLANERLITE-8000 series

This polishing slurry is designed for barrier metal in the Cu interconnection. Based on ultra purity colloidal silica with special additives, it delivers enough barrier metal removal rate with planarity to be kept by designed selectivity. Also it delivers minimal scratch and minimal roughness, as ideal polishing slurry.

■ PLANERLITE

Serie PLANERLITE-7000

La pasta pulidora se ha diseñado específicamente para la metalización de cobre en el proceso de damasquinado. Con base de silicio coloidal ultrapuro y aditivos especiales, ofrece un alto grado de eliminación del cobre y una excelente selectividad ante barreras metálicas. Por ello, la erosión es baja y el cobre residual en la barrera metálica es mínimo, lo que hace posible una estabilidad completa, sin sedimentación y un rayado mínimo. También ofrecemos un tipo con alto grado de dilución, lo que reduce el coste del proceso de damasquinado de cobre.

Serie PLANERLITE-8000

La pasta pulidora se ha diseñado para barrera metálica en la interconexión de cobre. Con base de silicio coloidal ultrapuro y aditivos especiales, ofrece un grado de eliminación de la barrera metálica suficiente, manteniendo la planitud según la selectividad. Es una pasta pulidora ideal, con rayado y tenacidad mínimos.